



2025年3月期
(2024年4月1日 ~ 2025年3月31日)

決算補足資料

2025年5月12日

ENOMOTO Co.,Ltd.

東証プライム 証券コード:6928

(1) 2025年3月期決算	P.3
(2) 2026年3月期業績予想	P.10

(1)2025年3月期決算



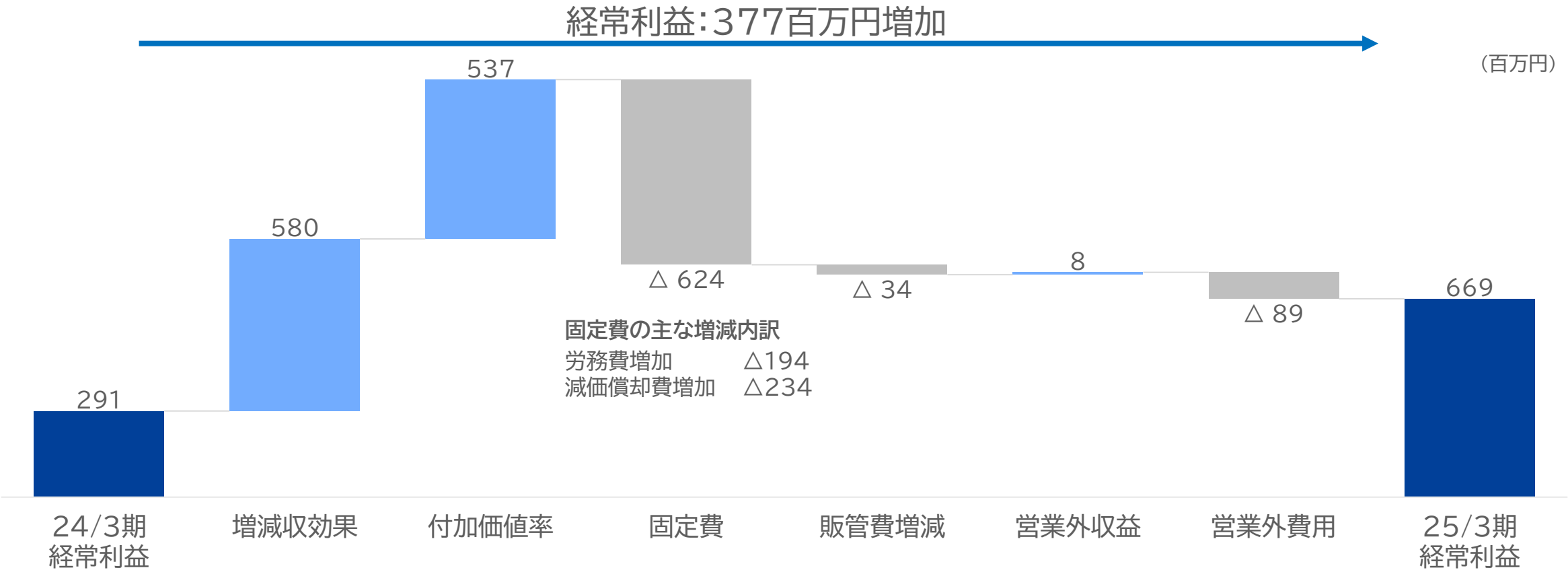
- 民生・産業機器向けのパワー半導体用リードフレームの生産調整の長期化も、オプト用リードフレーム、コネクタ用部品は底打ちして増収
- 工場稼働率が改善したことで利益率も向上
- 売上高、利益ともに為替変動の影響等は受けつつも、概ね従来予想通りに着地

単位:百万円	2023/3期		2024/3期		2025/3期		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	前期比(%)
売上高	29,265	100.0	25,244	100.0	26,880	100.0	6.5
売上総利益	4,100	14.0	2,654	10.5	3,147	11.7	18.6
販管費	2,538	8.7	2,494	9.9	2,528	9.4	1.4
営業利益	1,561	5.3	160	0.6	618	2.3	286.0
為替差損益	37	0.1	17	0.1	△65	-	-
受取利息	13	0.1	56	0.2	86	0.3	55.0
経常利益	1,805	6.2	291	1.2	669	2.5	129.3
当期純利益	1,269	4.3	121	0.5	447	1.7	269.3
1株当たり純利益	190.02円	-	18.16円	-	68.51円	-	
1株当たり配当金	60.0円		70.0円		71.0円	-	

- ・ パワー半導体用リードフレームは車載向けの成長が鈍化、民生・産業機器向けの在庫調整も続いた
- ・ オプト用リードフレームは、ハイエンド品の民生向けが車載向けに先行して量産開始
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン向けと車載向けは横ばいだが、ウェアラブル端末向けが底打ちし再成長

単位:百万円	2023/3期		2024/3期		2025/3期		前期比(%)
	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	
パワー半導体用 リードフレーム	11,973	40.9	11,112	44.0	10,771	40.1	△3.1
オプト用 リードフレーム	3,719	12.7	2,647	10.5	3,371	12.5	27.3
コネクタ用部品	12,912	44.1	10,989	43.5	12,085	45.0	10.0
その他	659	2.3	495	2.0	651	2.4	31.6
合計	29,265	100.0	25,244	100	26,880	100	6.5

- 増減収効果 ウェアラブル端末向け等のコネクタ用部品が増収、オプト用リードフレームも増収トレンドへ
- 付加価値率(ミックス改善) ①マイクロコネクタやクリップボンディングリードフレームの増加
 ②ハイエンドLED向けのオプト用リードフレームの増加
- 固定費 生産能力増強に伴い金型等の減価償却費増加、稼働率上昇により労務費も増加



- ・ 車載はパワー半導体用リードフレームは成長がやや鈍化、エアバッグ用コネクタは横ばい
- ・ スマートフォンは新モデル向けが前年比でやや減少、ウェアラブルが回復
- ・ 民生・産機・その他の汎用パワー半導体用リードフレームが調整継続、LEDはハイエンド品の金型売上及び量産が始まり増加

民生・産機・その他

- ・ 構成比は前期の28.4%から 0.4pt増加
前期比 5.2%増加
- ・ PC向けを含む汎用パワー半導体用
リードフレームの在庫調整
- ・ LED用リードフレームはハイエンド品
出荷開始により増加

ウェアラブル

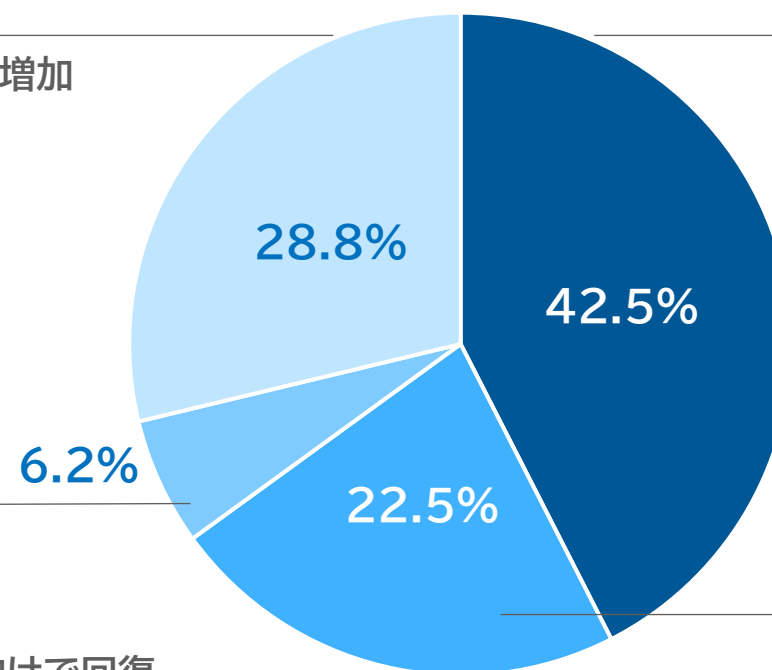
- ・ 構成比は前期の2.7%から 3.5pt増加
前期比 138.9%増加
- ・ ワイヤレスイヤホンやウォッチの新製品向けで回復

車載

- ・ 構成比は前期の44.5%から 2.0pt減少
前期比 1.0%減少
- ・ xEV向けパワー半導体用リードフレームは成長鈍化
- ・ エアバッグ向けコネクタ等は横ばい

スマートフォン

- ・ 構成比は前期の24.4%から 1.9pt減少
前期比 4.4%減少
- ・ スマートフォン向けコネクタ部品の減少



- 第4四半期はスマートフォンなどで季節調整があったが、オプト用リードフレームの増収等から前年同期比増収
- 利益面では、稼働率の上昇やオプト用リードフレームのハイエンド品や、コネクタ用部品のマイクロコネクタなど付加価値の高い製品の増加や稼働率の向上により前年同期比で増益

単位:百万円	2024/3期				2025/3期					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前同比 (%)	3Q比(%)
売上高	6,426	6,593	6,169	6,053	6,506	6,912	6,917	6,543	+8.1	△5.4
売上総利益	722	642	730	558	749	902	877	617	+10.6	△29.6
販管費	590	637	626	639	645	648	620	614	△4.0	△1.1
営業利益	132	4	103	△80	104	253	256	3	-	△98.5
為替差損益	12	16	△41	29	5	△61	35	△45	-	-
経常利益	162	27	89	12	135	228	332	△26	-	-
四半期純利益	96	△9	29	3	47	223	140	37	+846.1	△73.4

- ・ 売上高は2024年3月期4Qをボトムに回復トレンド
- ・ パワー半導体用リードフレームはEV向けの成長が一時鈍化、民生・産機向けは調整が続いた
- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品の量産により、増収トレンド入り
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン向けと車載向けは横ばい、ウェアラブル端末向けは増加

単位:百万円	2024/3期				2025/3期					
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前同比 (%)	3Q比 (%)
パワー半導体用 リードフレーム	3,164	2,832	2,516	2,598	2,662	2,734	2,738	2,637	+1.5	△3.7
オプト用 リードフレーム	712	662	648	624	728	742	901	998	+59.9	+10.8
コネクタ用部品	2,437	2,970	2,863	2,717	2,959	3,248	3,114	2,763	+1.7	△11.3
その他	112	129	141	112	156	188	163	144	+28.3	△11.8
合計	6,426	6,593	6,169	6,053	6,506	6,912	6,917	6,543	+8.1	△5.4

(2)2026年3月期業績予想



- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品が民生向けに続き車載向けも順次量産開始の予定で、着実な成長が続く
- ・ メッキや樹脂成形が必要な高付加価値製品をターゲットに受注活動強化、製造工程の自動化を加速し、増益を予想
- ・ 米国の関税政策による直接的な影響は僅少だが、金融・為替相場の混乱による景況の悪化など間接的な影響を注視

単位:百万円	2024/3期		2025/3期		2026/3期予想		期比較
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	予想	売上比(%)	前期比(%)
売上高	25,244	100.0	26,880	100.0	27,000	100.0	+0.4
売上総利益	2,654	10.5	3,147	11.7	3,600	13.3	+14.4
販管費	2,494	9.9	2,528	9.4	2,600	9.6	+2.8
営業利益	160	0.6	618	2.3	1,000	3.7	+61.6
経常利益	291	1.2	669	2.5	1,050	3.9	+56.9
当期純利益	121	0.5	447	1.7	700	2.6	+56.3
1株当たり当期純利益	18.16円	-	68.51円	-	107.07円	-	-
配当金	70.0円	-	71.0円	-	71.0円	-	-

- ・ パワー半導体向けリードフレームは中国の民生・産業機器向けが調整継続
- ・ オプト用リードフレームはハイエンド品の量産が順次開始、増収が続く
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン向けとウェアラブル端末向けが堅調に推移

単位:百万円	2024/3期		2025/3期		2026/3期		
	実績	構成比(%)	実績	構成比(%)	予想	構成比(%)	
パワー半導体用 リードフレーム	11,112	44.0	10, 771	40.1	10,000	37.0	△7.2
オプト用 リードフレーム	2,647	10.5	3, 371	12.5	4,300	15.9	+27.6
コネクタ用部品	10,989	43.5	12, 085	45.0	12,200	45.2	+1.0
その他	495	2.0	651	2.4	500	1.9	△23.3
合計	25,244	100	26,880	100.0	27,000	100.0	+0.4

- ・ パワー半導体向けリードフレームは足下は中国向けの民生・産業機器向けが調整継続
- ・ オプト用リードフレームは新規の受注案件が順次量産・出荷開始で確実な成長
- ・ コネクタ用部品は在庫調整が完了し、特にウェアラブル端末向けで市場成長による増加を見込む

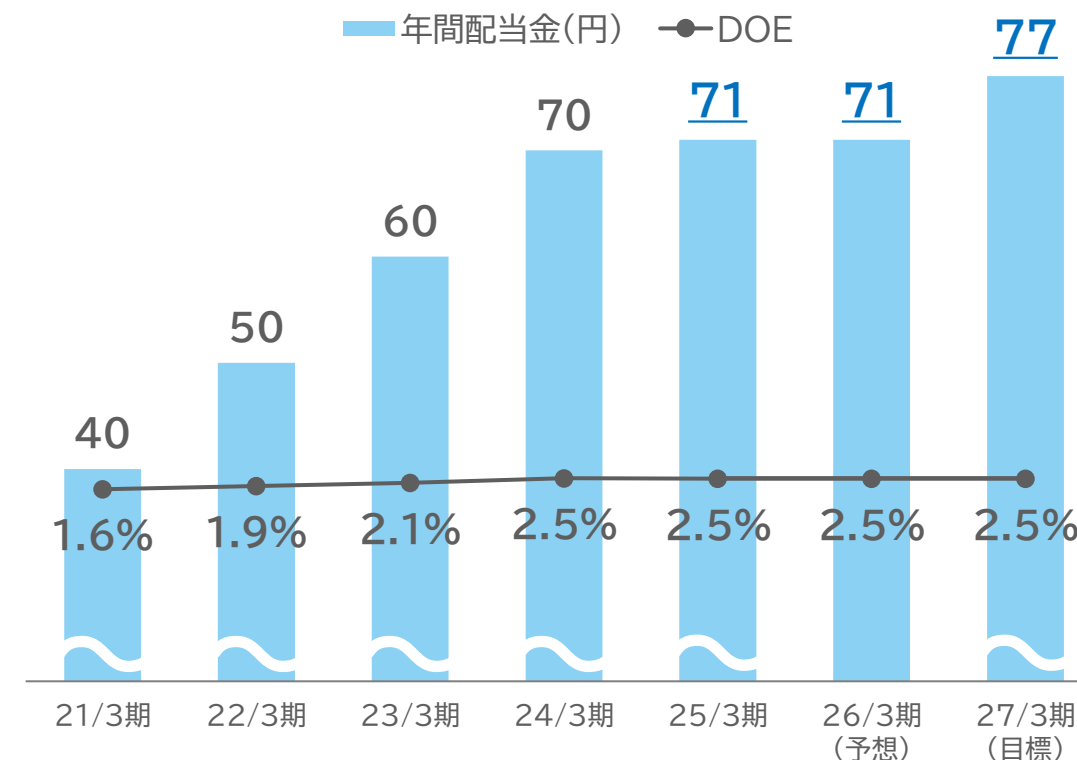
単位:百万円 矢印:前年同期比での方向性	2024/3期		2025/3期		2026/3期	2026/3期の方向性
	上期	下期	上期	下期		
パワー半導体用リードフレーム	5,996	5,115	5,396	5,375	10,000	
車載向け	▲	▲	▲	▶	▶	EV市場の成長鈍化や世界的な新車需要減速の影響。
民生・産機向け	▲	▲	▲	▶	▶	調整局面が継続。回復時期は不透明。
オプト用リードフレーム	1,374	1,272	1,470	1,900	4,300	
車載向け	▶	▲	▶	▲	▲	新規受注のハイエンド品の量産が本格化。
民生向け	▲	▲	▲	▲	▲	新規受注のハイエンド品の生産増加。
コネクタ用部品	5,408	5,581	6,208	5,877	12,200	
車載向け	▶	▲	▲	▶	▶	ADAS拡大状況しだいの上振れも。
モバイル向け	▲	▲	▲	▲	▶	前期並の予想だが、新モデルの販売次第で増加の可能性あり。
ウェアラブル向け	▲	▲	▲	▶	▲	在庫調整完了。市場成長に増加を予想。

- ・ 2023年5月に配当方針をDOE2.5%以上に変更、2025年3月期は71円(DOE2.5%)への増配を計画
- ・ 2026年3月期もDOE2.5%以上となる71円の配当を継続

2024年3月期以降の配当方針

- ・ DOE*2.5%以上を配当の数値基準とする
- ・ 中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- ・ 2025年3月期は71円配当を予定(DOE2.5%)

配当金・DOEの推移



* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本

注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。